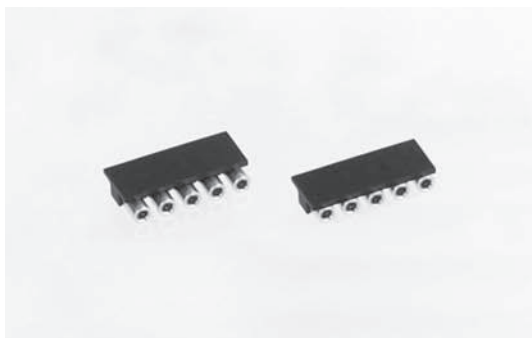




R8FM

表面実装PCBレセプタクル2.54mm PRECI-DIP

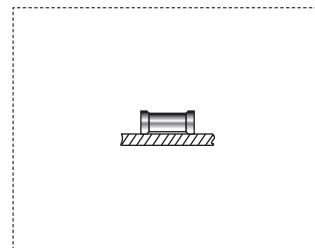
(寸法単位:mm)



SMD PCBレセプタクル
表面実装用ハンダ付タイプ

仕様

適合ピン径: $\varnothing 0.70 \sim 0.90\text{mm}$ 、 $\varnothing 0.635\text{mm}$
挿抜力: 挿入力 1.2N typ./引抜き力 0.6N typ.
(研磨したスチールゲージを使用 $\varnothing 0.76\text{mm}$)
機械的寿命: 500回(最低)
定格電流: 3A
接触抵抗: 10m Ω (最大)
耐電圧: 1,000Vrms(最低)
SMDコプラナリティー: 0.1mm



適合ピンシリーズ
R350/R450/R800/R802/
R804/R890/R892/R894



任意のピン数にカットして販売。

下記の標準ピン数以外をご希望される場合は、ピン数を変更するだけです。

型番構成例

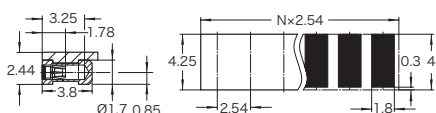
シリーズ **R8FM** - メッキ **78** または **38** - ピン数 **0002** - 形状番号 **02-278** (この型番の総ピン数は2ピンです)
任意のピン数を入れる。標準のピン数は下記参照。

R8FM...02-278シリーズ

🔍 テープ&リールも可(157ページ参照)

表面実装 1列 ピン数 2~10

メッキ仕上げ		ピン数		
スリーブ	コンタクト	10ピン	—	任意のピン数*
純錫	金 フラッシュ	R8FM-78-0010-02-278	—	R8FM-78-0xxx-02-278
純錫	0.75 μm 金	R8FM-38-0010-02-278	—	R8FM-38-0xxx-02-278



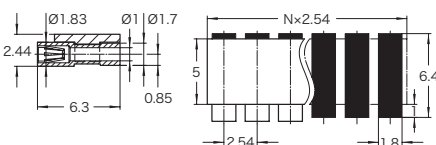
■ソケットピンのみを基板に平行に実装します。キャリアは実装後取り除きます ※xxxにピン数を入れて下さい。2~10ピン
例: R8FM-78-0010-02-278

R8FM...02-146シリーズ

🔍 テープ&リールも可(157ページ参照)

表面実装 1列 ピン数 2~10

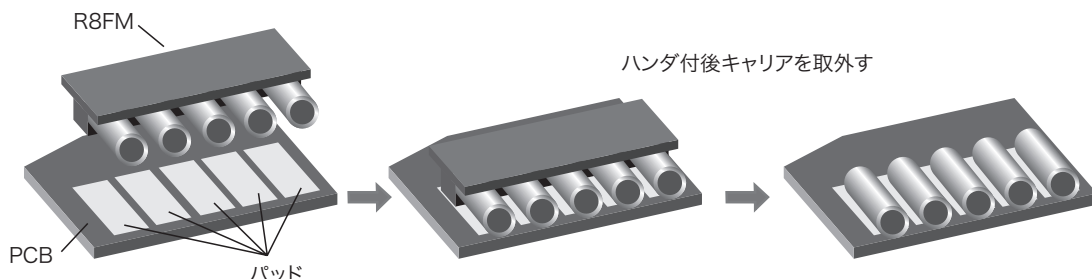
メッキ仕上げ		ピン数		
スリーブ	コンタクト	10ピン	—	任意のピン数*
純錫	金 フラッシュ	R8FM-78-0010-02-146	—	R8FM-78-0xxx-02-146
純錫	0.75 μm 金	R8FM-38-0010-02-146	—	R8FM-38-0xxx-02-146



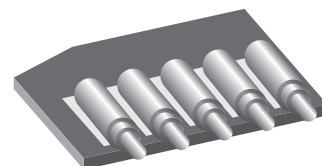
■ソケットピンのみを基板に平行に実装します。キャリアは実装後取り除きます ※xxxにピン数を入れて下さい。2~10ピン
例: R8FM-78-0010-02-146

表面実装PCBレセプタクルの使用方法

基板に実装後、ピンに取付けられていたキャリアを取り除くことによりピンだけが基板に実装されます。省スペース・低背化が可能です。



オスピンタイプもあります
R8MM-11...02-279シリーズ
(082ページ参照)





PCBコネクタ/レセプタクル一般仕様

以下の仕様は、PCBレセプタクル及びコネクタに適用の一般仕様です。追加および製品仕様のテクニカルデータについては個々のカタログページをご覧ください。

一般仕様

動作温度範囲	-55~+125°C
耐候性分類(IEC)	55/125/21
動作湿度範囲(域)	年平均75%
最大定格電圧	AC100Vrms/DC150V(2.54mmピッチ)

UL PRECI-DIP製品はUL(Underwriters Laboratories Inc.)認定品です。
UL規格「データ、信号、制御及び電力用途使用のコネクタ」にリストされています。File Nr. E174442

機械的特性

クリップ維持力	40N(最小、軸方向力適用では無変位)
コンタクト(スリーブ/クリップ)維持力	3.3N(最小) MIL-DTL-83734,pt4.6.4.2

電機的特性

隣接コンタクト間での絶縁抵抗値	10,000MΩ(最小、500Vacにて)				
隣接コンタクト間の静電容量	1pF(最大)				
隣接コンタクト間の沿面距離	3xx/4xx/7xxシリーズ 0.7mm	80xシリーズ 0.85/0.7mm	83xシリーズ 0.5mm	85xシリーズ 0.4/0.5mm	86xシリーズ 0.5mm

環境特性 ソケットは以下の環境試験において機械的/電気的に支障無く耐えることが出来ます。

乾熱試験	IEC 60512-11-9.11i/60068-2-2.Bb	温度125°C, 16時間
湿熱試験	IEC 60512-11-12.11m/60068-2-30.Db	温度25/55°C, 湿度90-100%RH, 1サイクル24時間
低温試験	IEC 60512-11-10.11j/60068-2-1.A	温度-55°C, 2時間
熱ショック試験	IEC 60512-11-4.11d/60068-2-14.Na	温度-55/125°C, 5サイクル30分
振動(正弦)試験*	IEC 60512-6-4.6d/60068-2-6.Fc	10~500Hz, 10g, 1オクターブ/分, 各軸方向10サイクル
衝撃試験*	IEC 60512-6-3.6c/60068-2-27.Ea	50g, 11ms, 3軸方向3衝撃

※上記二つの試験中に50ns以上のコンタクトの瞬断が無い事。

ハンダ付性	J-STD-002A	Test A, 245°C, 5秒間, ハンダ SnAg3.8Cu0.7
ハンダ付耐熱性	J-STD-020C	260°C, 20秒
耐湿性	J-STD-020C	level 1
耐腐食性	1) 塩水噴霧試験	IEC 60068-2-11.Ka 48時間
	2) 二酸化硫黄ガス(SO2)試験	IEC 60068-2-42 Kc 25ppm SO ₂ , 25°C, 75%RHで96時間
	3) 硫化ガス(H2S)試験	IEC 60068-2-43 Kd 12ppm H ₂ S, 25°C, 75%RHで96時間

無ハンダ対応プレスフィット特性 プレスフィット特性はIEC60325 -5に対応して測定されています。

挿入力	90N(最大)@最小穴直径/65N typ.	
引抜き力	30N(最小)@最大穴直径/50N typ.	
引抜き力 3サイクル時	20N(最小)@最大ホール直径	
PCBホール寸法	2mmピッチ	仕上げ穴: Ø0.7+0.09/-0.06mm, ドリル穴: Ø0.8±0.2mm
	2.54mmピッチ	仕上げ穴: Ø2+0.09/-0.06mm0, ドリル穴: Ø1.15±0.02mm
PCBホールメッキ	PCB表面処理	ホールメッキ
	錫	5-15µm錫(最小、25µm銅の上)
	銅	25µm(最小)
	金(ニッケル上)	0.05-0.2µm金(最小、25µm銅の上に2.5-5µmニッケル)

材質

シリーズ	右記以外	R830/R831/R832/R833	R831...64-001/R833...64-001/ R831...64-242/R833...64-245
インシュレーター	ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル、UL94 V-0、黒色、PCT-GF30FR	ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル、UL94 V-0、黒色、LCP-GF30-FR	ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル、UL94 V-0、黒色、LCP-GF30-FR
スリーブ	CuZn36Pb3(C36000)	CuZn36Pb3(C36000)	CuDn4Pb4Zn4(C54400)
コンタクト		ベリリウム銅(C17200)	

